

ウェッタブルフランクパッケージ

ウェッタブルフランク パッケージ

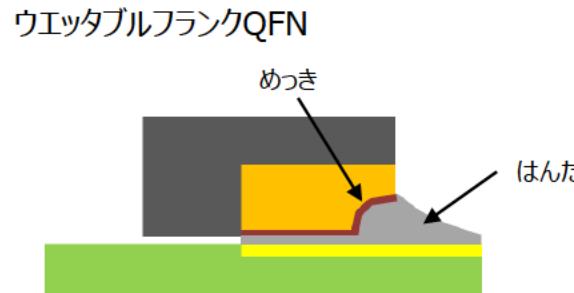
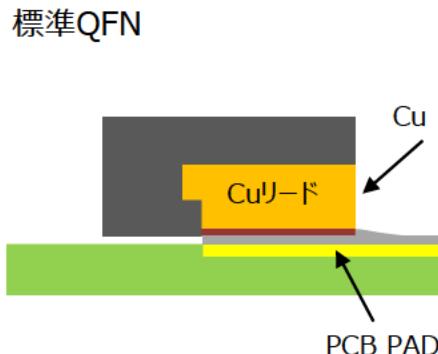
背景

自動車の安全性・信頼性を向上させるために、自動車メーカーでは組立後の自動外観検査（AVI）を義務付けています。しかしながら、QFN等のノンリードパッケージでは、パッケージ上面からでは端子が露出していないために、プリント回路基板（PCB）に正しく実装されているかどうかの判断が非常に困難です。QFNパッケージの問題点は、端子の側面が露出しているもののCu無垢のために酸化しやすく、はんだ濡れ性が悪いために実装性の低下を招くことです。

そこで求められているのが端子側面の一部までめっきを施すことで、はんだ濡れ性を確保する技術です。

⇒Wettable Flank

構造比較(標準品 vs ウエッタブルフランク)

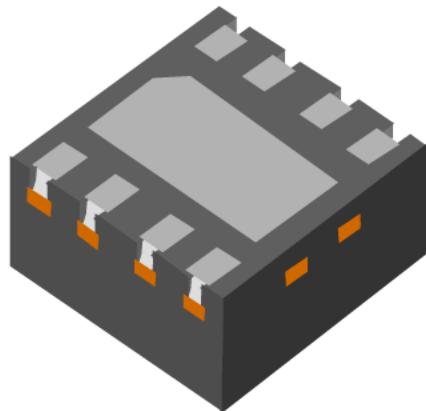
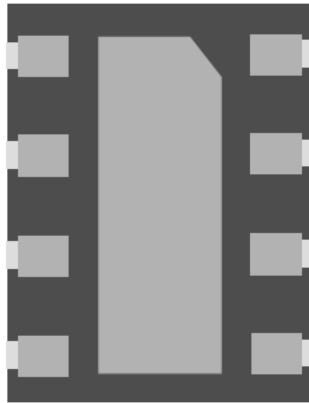


⇒良好なサイドフィレットを形成可能

ウェッタブルフランク パッケージ

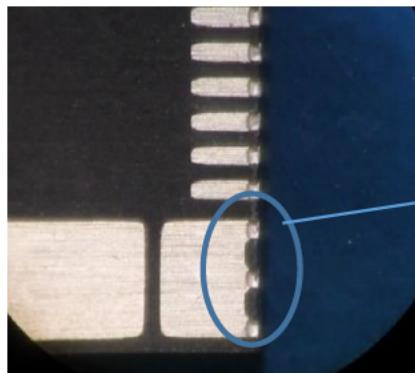
ラインナップ

■段差リードタイプ

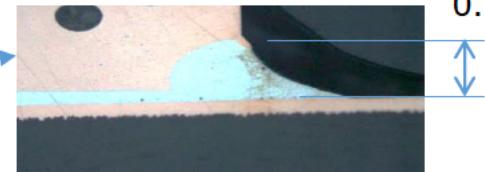


■プリモールドフレームタイプ

開発中

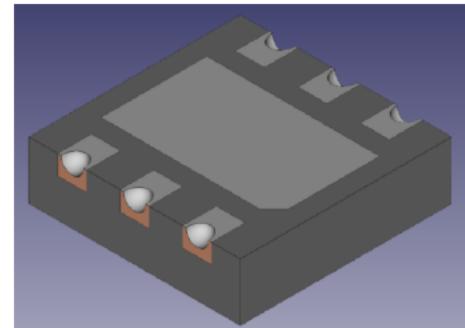
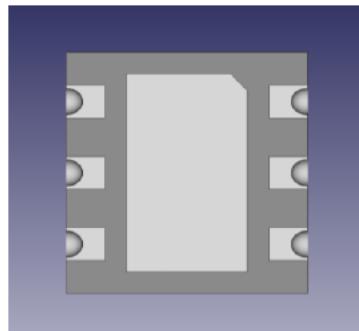


サイドフィレット



■ディンプルタイプ[®]

構想中



プリモールドフレームによる
組立フローイメージ

プリモールド
(1次成型)
@フレームメーカー



ダイボンド
ワイヤボンド



モールド
(2次成型)



ダイシング



ATTENTION

本資料には機密情報が含まれておりますので、事前にアオイ電子の書面による承諾がない限り、本資料の内容を開示、複製、配布、またはそれに依拠した行為を固く禁じます。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。